

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成31年2月28日 (2019.2.28)

【公開番号】特開2018-87921(P2018-87921A)

【公開日】平成30年6月7日 (2018.6.7)

【年通号数】公開・登録公報2018-021

【出願番号】特願2016-231491(P2016-231491)

【国際特許分類】

G 0 9 F 9/00 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 B 33/02 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

G 0 2 F 1/13 (2006.01)

G 0 2 F 1/1333 (2006.01)

【 F I 】

G 0 9 F 9/00 3 3 8

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/02

H 0 5 B 33/10

G 0 2 F 1/13 1 0 1

G 0 2 F 1/1333 5 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成30年12月21日 (2018.12.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 5 3 】

上記第 1 の実施の形態で説明したのと同様にして、保護層 1 4 まで形成した後、支持基板 9 の裏面 S 2 に高粘度材料 3 2 を塗布する。これにより、支持基板 9 の裏面 S 2 が高粘度材料 3 2 に接触するようになる。続いて、支持基板 9 の裏面 S 2 を高粘度材料 3 2 に接触させた状態で、支持基板 9 の裏面 S 2 側からレーザ光 L を照射する。この後、高粘度材料 3 2 を除去し、支持基板 9 を可撓性基板 1 1 から剥離する。